

2026年03月18日

泰金新能 (688813.SH)

新股覆盖研究

投资要点

- ◆ 本周二（3月17日）有一家科创板上市公司“泰金新能”询价。
- ◆ **泰金新能（688813）**：公司主营业务为高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售。公司2023-2025年分别实现营业收入16.69亿元/21.94亿元/23.95亿元，YOY依次为66.18%/31.42%/9.16%；实现归母净利润1.55亿元/1.95亿元/2.04亿元，YOY依次为58.04%/25.78%/4.38%。根据公司初步预测，公司2026Q1营业收入较2025年同期减少28.08%至42.46%，归母净利润较2025年同期减少45.38%至57.52%。

机械 | 其他专用机械III

交易数据

总市值（百万元）	
流通市值（百万元）	
总股本（百万股）	120.00
流通股本（百万股）	
12个月价格区间	/

分析师

李蕙
 SAC执业证书编号：S0910519100001
 lihui1@huajinsec.cn

报告联系人

戴筝筝
 daizhengzheng@huajinsec.cn

相关报告

- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（盛龙股份）-2026年26期-总第663期 2026.3.18
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（新恒泰）-2025年23期-总第660期 2026.3.13
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（宏明电子）-2026年20期-总第657期 2026.3.10
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（视涯科技）-2026年22期-总第659期 2026.3.10
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（族兴新材）-2025年21期-总第658期 2026.3.10

② **投资亮点：1、公司是我国高性能铜箔生产线整体解决方案商龙头、可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案。**公司设立于2000年，是西北有色院控股子公司、实际控制人是陕西省财政厅；西北有色院为1965年国家重点设立的稀有金属材料研究基地、其研发技术实力雄厚。公司设立初期仅从事钛电极的研制，于2010年成立电解设备研发团队、聚焦行业内“卡脖子”问题；2012年起，公司陆续研制出阴极辊、生箔一体机、表面处理机、高效溶铜系统等电解铜箔生产的关键核心设备，并于2020年实现了高端铜箔生产线全套产品技术的自主可控，具备提供整体解决方案的能力，成功打破国外技术封锁。目前，公司已成为国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业，可实现生产4-6 μm 高端极薄铜箔、6-10 μm 超薄铜箔及用于印制电路板（PCB）制造的高性能电子电路铜箔（10 μm 以上）；且整体技术已达到国际先进水平，2022年率先研制出成功全球最大直径3.6m阴极辊及生箔一体机。得益于产品优势，公司实现了国内大部分电解铜箔生产厂商及部分海外厂商的供货；2024年，公司阴极辊及铜箔钛阳极产品的国内市占率均位居第一，其中阴极辊国内市占率达45%以上。据招股书披露，随着下游铜箔行业持续复苏回暖，公司陆续新签大额订单，预计2026年上半年将完成发货439台设备、远超原定目标303台；截至2025年9月末，公司电解成套装备在手订单金额（不含税）达26.22亿元。**2、公司继续瞄准铜箔行业重大前沿需求，积极开展芯片封装用极薄载体铜箔、高频高速电路用超低轮廓铜箔、PET复合铜箔等领域关键成套装备的研制。**（1）针对我国芯片封装用极薄载体铜箔、高频高速电路用超低轮廓铜箔等高端铜箔生产的“卡脖子”关键装备问题，公司牵头承担科技部国家重点研发计划“高强极薄铜箔制造成套技术及关键装备”专项科研项目，目前已完成载体铜箔相关成套装备的开发并实现了1.5 μm 载体铜箔的试制，通过了华为等终端客户应用验证。未来，随着国内AI、5G高速通信、云计算等电子信息行业的快速发展，下游更多的高端电子电路铜箔产能建设订单将转向国内企业，高端电子电路领域对电解成套装备需求也将变得更为迫切，并进一步拉动对上游设备的需求。（2）针对PET复合铜箔，公司已开发出复合铜箔磁控溅射装备和水镀线样机、完成了复合铜箔的批量试制，并与金川集团、嘉元科技、冠宇股份等下游客户建立了合作意向，预计2026年有望实现批量销售。据GGII预测，复合铜箔作为锂电池新型集流体材料，具有安全性高、重量轻、柔性好、原材料成本低等优势，有望率先在低速四轮车、锂电二轮车、数码电子等市场实现应用，并逐步延伸至智能



穿戴、低空经济等新兴领域；预计 2028 年复合铜箔市场渗透率有望达 16%、对应复合铜箔装备市场规模约 75 亿元，市场前景广阔。

① **同行业上市公司对比：**根据业务的相似性，选取洪田股份、东威科技、杭可科技、利元亨、金银河为泰金新能的可比上市公司。从上述可比公司来看，2024 年可比上市公司的平均收入规模为 18.19 亿元，平均 PS-TTM（算数平均）为 7.45X，销售毛利率为 22.47%；相较而言，公司营收规模处于同业的中高位区间，销售毛利率则未及同业平均。

◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

公司近 3 年收入和利润情况

会计年度	2023A	2024A	2025A
主营收入(百万元)	1,669.4	2,193.9	2,394.9
同比增长(%)	66.18	31.42	9.16
营业利润(百万元)	173.3	214.1	224.8
同比增长(%)	59.40	23.58	4.97
归母净利润(百万元)	155.3	195.4	203.9
同比增长(%)	58.04	25.78	4.38
每股收益(元)	1.29	1.63	1.70

数据来源：聚源、华金证券研究所

内容目录

一、泰金新能.....	4
(一) 基本财务状况.....	4
(二) 行业情况.....	5
(三) 公司亮点.....	9
(四) 募投项目投入.....	10
(五) 同行业上市公司指标对比.....	10
(六) 风险提示.....	11

图表目录

图 1: 公司收入规模及增速变化.....	4
图 2: 公司归母净利润及增速变化.....	4
图 3: 公司销售毛利率及净利润率变化.....	5
图 4: 公司 ROE 变化.....	5
图 5: 2019-2028 年中国铜箔设备市场规模及预测 (亿元).....	6
图 6: 2019-2028 年中国电解铜箔生箔机设备市场规模及预测 (亿元).....	6
图 7: 2019-2028 年全球及中国电解铜箔钛阳极板市场规模及预测 (亿元).....	7
图 8: 2015-2023 年中国锂原电池市场规模统计 (亿元).....	8
图 9: 2015-2024 年全球连接器市场规模 (亿美元).....	8
图 10: 2018-2024 年中国连接器行业市场规模及预测 (亿元).....	8
图 11: 2017-2024 年中国集成电路销售规模及预测 (亿元).....	9
表 1: 公司 IPO 募投项目概况.....	10
表 2: 同行业上市公司指标对比.....	11

一、泰金新能

公司专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售，是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业，同时也是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。公司产品终端应用于大型计算机、5G 高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。

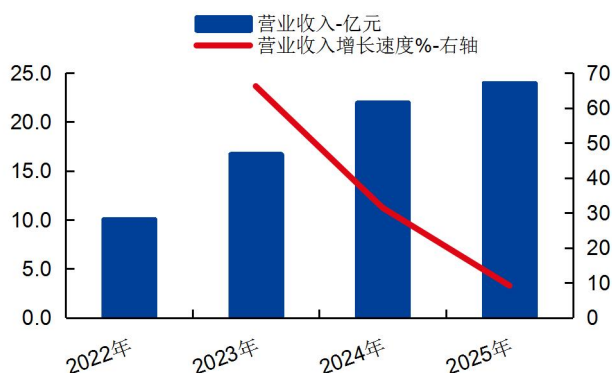
2021 年，公司牵头承担科技部国家重点研发计划“高强极薄铜箔制造成套技术及关键装备”专项科研项目，旨在解决我国芯片封装用极薄载体铜箔、高频高速电路用超低轮廓铜箔等高端铜箔生产的“卡脖子”关键装备问题；2022 年，公司参与国家重点研发计划“电解水制高压氢电解堆及系统关键技术”项目，旨在解决我国在高压/高压差 PEM 电解堆关键材料制备的技术难题；2022 年，公司完成“华龙一号”核电反应堆用玻璃密封电气贯穿件国产化项目，为我国核电用玻璃封接电气贯穿件提供了国产化方案；2024 年，公司参与工信部国家产业基础再造和制造业高质量发展专项项目之“氢能用金属扩散层关键材料项目”，旨在解决 PEM 电解水制氢用多孔传输层批量化生产中的技术难题。截至本招股意向书签署日，公司拥有授权发明专利 98 项（含 2 项美国发明专利）、实用新型专利 126 项，外观设计专利 7 项。

（一）基本财务状况

公司 2023-2025 年分别实现营业收入 16.69 亿元/21.94 亿元/23.95 亿元，YOY 依次为 66.18%/31.42%/9.16%；实现归母净利润 1.55 亿元/1.95 亿元/2.04 亿元，YOY 依次为 58.04%/25.78%/4.38%。

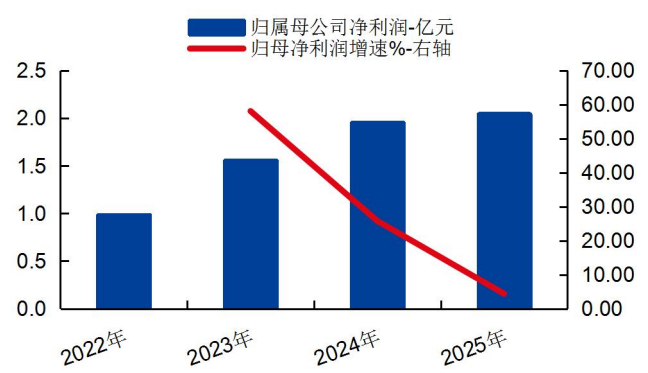
2025H1，公司主营业务收入按产品类别可分为三大板块，分别为电解成套装备（7.50 亿元，占 2025H1 主营收入的 65.11%）、钛电极（3.33 亿元，2025H1 主营收入的 28.94%）、金属玻璃封接（0.69 亿元，占 2025H1 主营收入的 5.95%）。2022 年至 2025H1，电解成套装备始终为公司主要收入来源，其收入占比稳定在 50%以上。

图 1：公司收入规模及增速变化



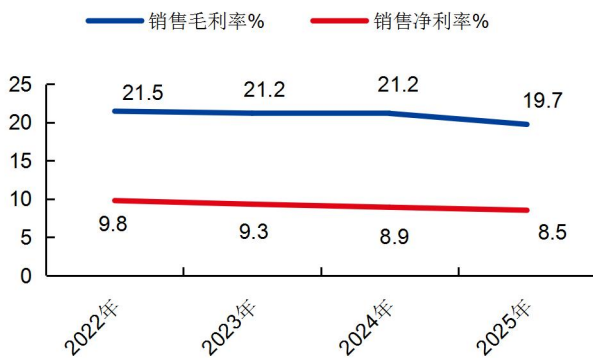
资料来源：wind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



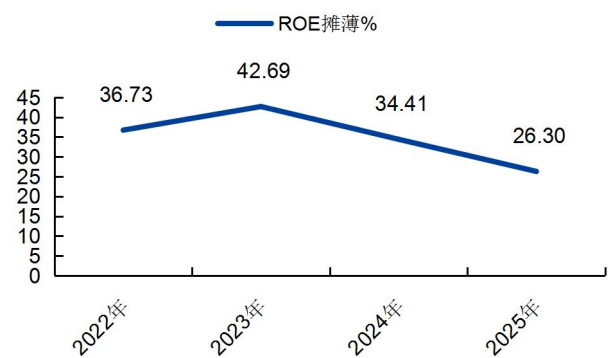
资料来源：wind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利润率变化



资料来源：wind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化



资料来源：wind，华金证券研究所

（二）行业情况

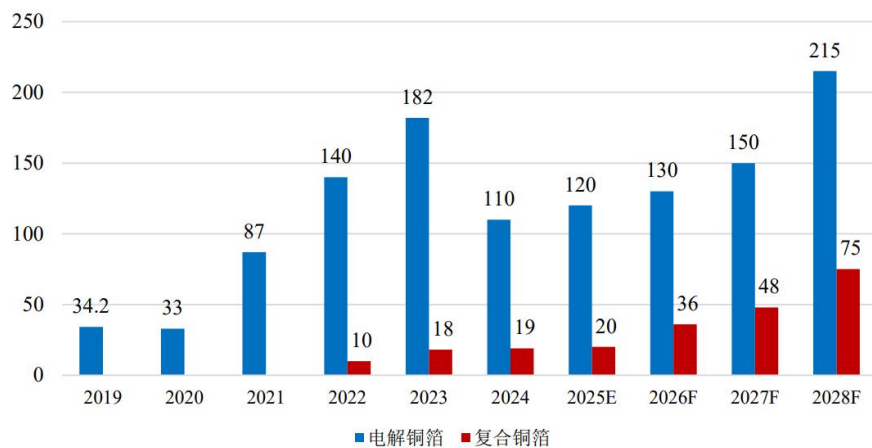
公司专注于电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品；根据主营产品类别，分别归属于电解成套装备及钛电极行业、金属玻璃封接行业。

1、电解成套装备及钛电极行业

电解成套装备及铜箔钛阳极所属行业与下游电解铜箔行业密切相关，生产的设备主要应用于下游电解铜箔的生产加工，包括电子电路铜箔、锂电铜箔等。近年来，受益于全球新能源汽车销量的快速增长，全球及国内锂电铜箔市场需求呈快速增长态势，主流电解铜箔企业纷纷投资建设生产线，进而拉动铜箔生产设备需求快速增长。另一方面，铜箔核心生产设备的国产化率有了极大提升；2019 年之前，国内铜箔核心生产设备的国产化率相对较低，部分设备需依赖国外企业，如阴极辊等，加之当时锂电铜箔产品正处于极薄化发展起始阶段，国内头部铜箔企业采用进口设备较多；2020 年以来，国内相关极薄铜箔设备已经完成验证并实现出货，行业设备国产化率快速提升。

根据高工锂电（GGII）数据，2023 年中国电解铜箔设备的市场规模为 200 亿元，较 2022 年市场规模增长 33.33%，2024 年行业进入调整期，新的产能扩建项目有所减少，但随着行业的修复、更高性能的铜箔设备的推出、海外出口及复合铜箔市场的发展等因素影响，高工锂电（GGII）预测 2028 年中国铜箔设备将达到 290 亿元。

图 5：2019-2028 年中国铜箔设备市场规模及预测（亿元）



资料来源：高工锂电（GGII），华金证券研究所

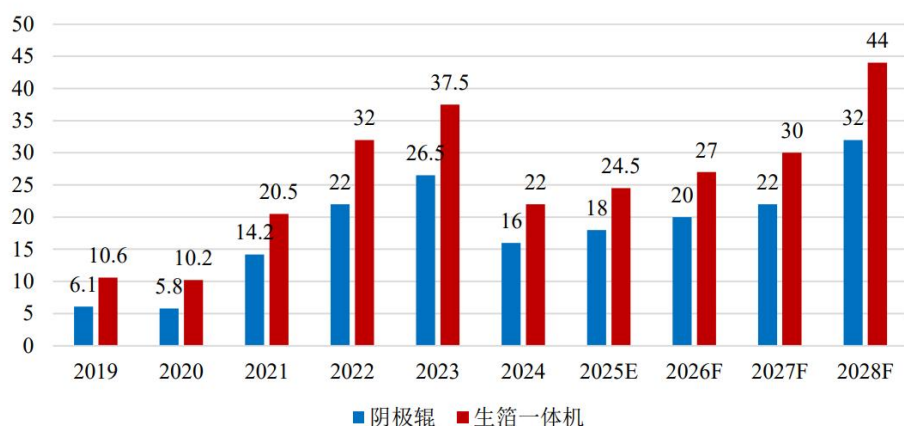
备注：市场规模包含国内电解铜箔设备出货、海外设备出口、复合铜箔设备合计（相关配套设备、设施）

在铜箔设备需求旺盛的同时，作为铜箔生产设备所用耗材的铜箔钛阳极，需要定期进行更换，同样受到下游铜箔厂商巨大需求的拉动，未来市场空间较大。除铜箔钛阳极外，其他阳极产品在铝箔化成、湿法冶金、环保水处理等领域应用较多。

（1）阴极辊及生箔一体机细分市场

据高工锂电（GGII）数据显示，2023 年中国铜箔用阴极辊设备市场规模为 26.5 亿元，同比增长 20.45%，2024 年行业进入调整期，预计到 2028 年中国阴极辊设备市场规模将达到 32 亿元；另一方面，作为与阴极辊配套的生箔一体机，近年来也迎来高速增长的市场需求，2023 年中国铜箔生箔一体机市场规模为 37.5 亿元，同比增长 17.19%，预计到 2028 年中国生箔一体机设备市场规模将达到 44 亿元。未来，随着下游产业对大直径、大幅宽阴极辊的加速应用，相关高端装备将成为市场主要需求。

图 6：2019-2028 年中国电解铜箔生箔机设备市场规模及预测（亿元）

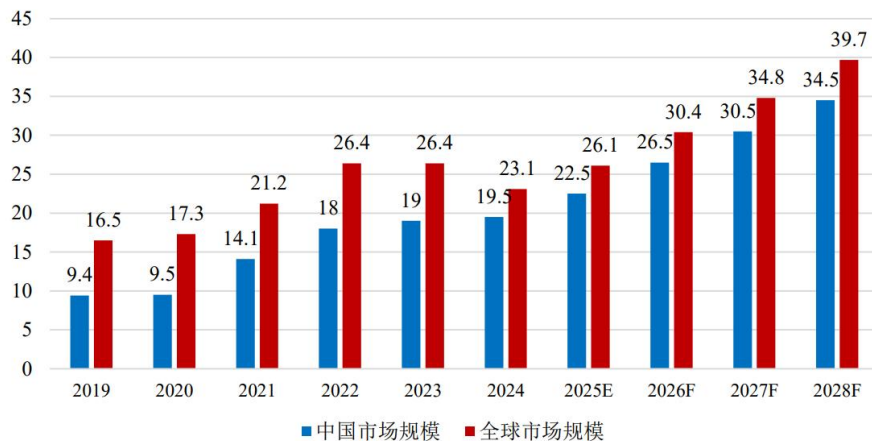


资料来源：高工锂电（GGII），华金证券研究所

（2）铜箔钛阳极细分市场

铜箔钛阳极作为铜箔生产中使用的耗材类零部件，锂电铜箔钛阳极一般寿命约为 6 个月，稍短于电子电路铜箔钛阳极寿命，铜箔生产时均需采购铜箔钛阳极，叠加未来下游持续新建落地产能，将带动铜箔钛阳极市场需求大规模增长。据高工锂电（GGII）数据显示，2024 年中国电解铜箔用阳极板市场规模为 19.5 亿元，预计 2025 年中国电解铜箔用阳极板市场规模将达 22.5 亿元，到 2028 年中国电解铜箔用阳极板市场规模将达到 34.5 亿元，2024-2028 年的年均复合增长率为 15.33%；2028 年全球电解铜箔用阳极板市场规模将达到 39.7 亿元，2024-2028 年的年均复合增长率为 14.50%。

图 7：2019-2028 年全球及中国电解铜箔钛阳极板市场规模及预测（亿元）



资料来源：高工锂电（GGII），华金证券研究所

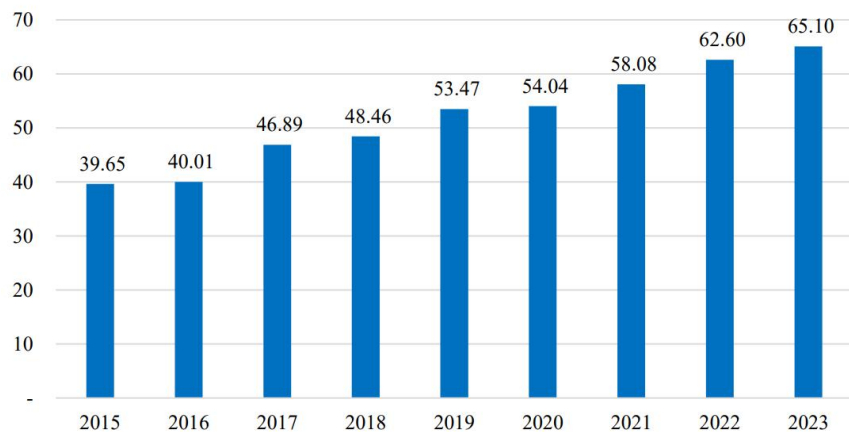
2、金属玻璃封接行业

（1）新能源电池密封组件细分市场

新能源电池密封组件是锂原电池和热电池生产所需的关键部件。锂原电池具有比能量大、单体电池电压高、使用温度范围广，储存寿命长，放电电压平稳等优点，被应用于智能仪表、电子行业、医疗器械、通讯设备及军工领域；热电池具有高比功率和高比能量的优点，主要应用于军用电源系统。

据共研产业研究院、智研咨询、新思界产业研究中心 2015-2023 年行业数据分析，国内锂原电池市场规模稳步增长，市场规模从 2015 年的 39.65 亿元预期增长到 2023 年的 65.10 亿元。伴随物联网、智能安防等下游众多新兴应用市场的兴起，预计国内锂原电池的需求量将进一步扩大。

图 8：2015-2023 年中国锂离子电池市场规模统计（亿元）



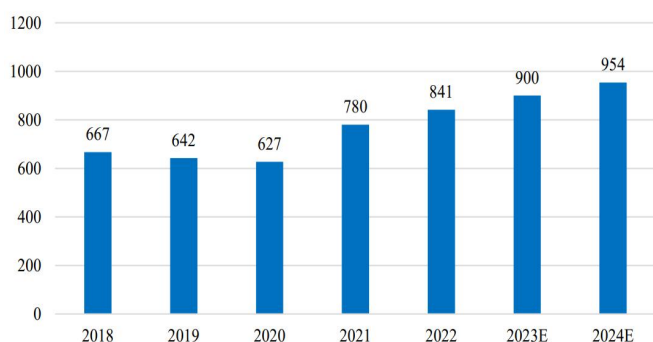
资料来源：共研产业研究院，智研咨询，新思界产业研究中心，华金证券研究所

（2）连接器密封组件细分市场

连接器密封组件是连接器的核心部件，连接器是构成整机电路系统电气连接所必须的基础元件。随着国内在军工、航空航天、通信、汽车、消费电子、医疗、家居等多个领域的快速发展，中国目前已经成为世界上最大的连接器生产基地和消费市场，下游行业需求将带动中国连接器市场持续增长，进而带动对连接器密封组件需求的增长。根据 Bishop&Associates 数据，全球连接器市场规模已从 2018 年的 667 亿美元增长至 2022 年的 841 亿美元。连接器行业对下游应用领域变化反应敏锐，终端市场的规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大，据 Bishop&Associates 预计，2023 年全球连接器市场规模将会达到 900 亿美元，2024 年市场规模将进一步增至 954 亿美元。

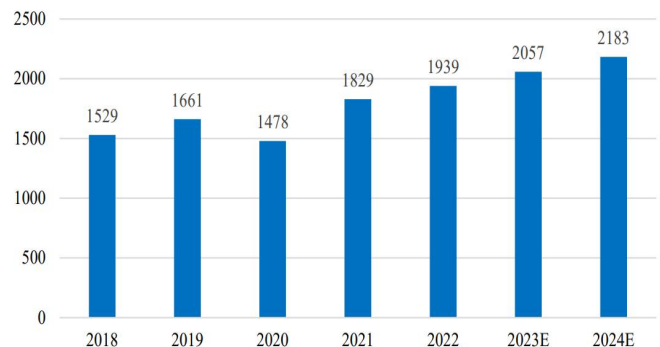
从国内来看，受益于通信、消费电子、新能源汽车、工控安防等下游行业的持续发展，中国连接器行业市场规模不断增长，已经成为世界上最大的连接器生产基地。中商产业研究院发布的《2024—2029 年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，2022 年中国连接器市场规模为 1,939 亿元，近五年年均复合增长率为 6.11%。中商产业研究院预测，2023 年中国连接器市场规模将达到 2,057 亿元，2024 年规模达到 2,183 亿元。

图 9：2015-2024 年全球连接器市场规模（亿美元）



资料来源：Bishop&Associates，中商产业研究院整理，华金证券研究所

图 10：2018-2024 年中国连接器行业市场规模及预测（亿元）

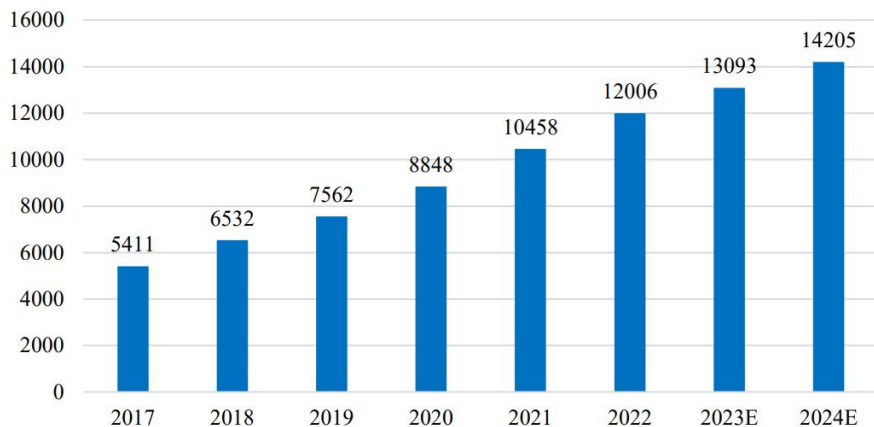


资料来源：中商产业研究院，华金证券研究所

（3）混合集成电路封装外壳细分市场

混合集成电路封装外壳是混合集成电路的关键核心部件。混合集成电路具有组装密度大、可靠性高、电性能优、体积小、寿命长等优点，是我国“十四五”大力支持和重点发展的行业，随着军工电子、新能源汽车、物联网等行业的需求增加而持续增长，据中商产业研究院报告显示，中国集成电路销售额自 2017 年以来快速增长，2022 年中国集成电路销售规模达到 12,006 亿元，年复合增长率为 17.28%，2023 年预计达 13,093 亿元，2024 年预计达 14,205 亿元，带动混合集成电路封装外壳的需求持续增长。

图 11：2017-2024 年中国集成电路销售规模及预测（亿元）



资料来源：中国半导体行业协会，中商产业研究院整理，华金证券研究所

（三）公司亮点

1、公司是我国高性能铜箔生产线整体解决方案商龙头、可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案。公司设立于 2000 年，是西北有色院控股子公司、其实控人为陕西省财政厅；西北有色院为 1965 年国家重点设立的稀有金属材料研究基地、其研发技术实力雄厚。公司设立初期仅从事钛电极的研制，于 2010 年成立电解设备研发团队、聚焦行业内“卡脖子”问题；2012 年起，公司陆续研制出阴极辊、生箔一体机、表面处理机、高效溶铜系统等电解铜箔生产的关键核心设备，并于 2020 年实现了高端铜箔生产线全套产品技术的自主可控，具备提供整体解决方案的能力，成功打破国外技术封锁。目前，公司已成为国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业，可实现生产 4-6 μm 高端极薄铜箔、6-10 μm 超薄铜箔及用于印制电路板（PCB）制造的高性能电子电路铜箔（10 μm 以上）；且整体技术已达到国际先进水平，2022 年率先研制出成功全球最大直径 3.6m 阴极辊及生箔一体机。得益于产品优势，公司实现了国内大部分电解铜箔生产厂商及部分海外厂商的供货；2024 年，公司阴极辊及铜箔钛阳极产品的国内市占率均位居第一，其中阴极辊国内市占率达 45% 以上。据招股书披露，随着下游铜箔行业持续复苏回暖，公司陆续新签大额订单，预计 2026 年上半年将完成发货 439 台设备、远超原定目标 303 台；截至 2025 年 9 月末，公司电解成套装备在手订单金额（不含税）达 26.22 亿元。

2、公司继续瞄准铜箔行业重大前沿需求，积极开展芯片封装用极薄载体铜箔、高频高速电路用超低轮廓铜箔、PET 复合铜箔等领域关键成套装备的研制。（1）针对我国芯片封装用极薄载体铜箔、高频高速电路用超低轮廓铜箔等高端铜箔生产的“卡脖子”关键装备问题，公司牵头承

担科技部国家重点研发计划“高强极薄铜箔制造成套技术及关键装备”专项科研项目，目前已完成载体铜箔相关成套装备的开发并实现了 1.5 μm 载体铜箔的试制，通过了华为等终端客户应用验证。未来，随着国内 AI、5G 高速通信、云计算等电子信息行业的快速发展，下游更多的高端电子电路铜箔产能建设订单将转向国内企业，高端电子电路领域对电解成套装备需求也将变得更为迫切，并进一步拉动对上游设备的需求。（2）针对 PET 复合铜箔，公司已开发出复合铜箔磁控溅射装备和水镀线样机、完成了复合铜箔的批量试制，并与金川集团、嘉元科技、冠宇股份等下游客户建立了合作意向，预计 2026 年有望实现批量销售。据 GGII 预测，复合铜箔作为锂电池新型集流体材料，具有安全性高、重量轻、柔性好、原材料成本低等优势，有望率先在低速四轮车、锂电二轮车、数码电子等市场实现应用，并逐步延伸至智能穿戴、低空经济等新兴领域；预计 2028 年复合铜箔市场渗透率有望达 16%、对应复合铜箔装备市场规模约 75 亿元，市场前景广阔。

（四）募投资项目投入

公司本轮 IPO 募投资金拟投入 3 个项目。

1、绿色电解用高端智能成套装备产业化项目：项目的实施将有利于推动公司研发成果的转化速度，实现高端电解成套装备技术的不断提升，打破芯片封装用极薄载体铜箔、高频高速电路用超低轮廓铜箔等高端铜箔的“卡脖子”问题，并有利于推动新能源电池用 PET 复合铜箔技术、光伏镀铜技术的发展与产业化并形成市场销售；根据公司初步预测，项目达产后正常年份实现营业收入 26.35 亿元，利润总额 2.89 亿元，净利润 2.46 亿元。

2、高性能复合涂层钛电极材料产业化项目：项目的实施将有利于推动公司的科技成果转化，有助于公司提高生产能力，扩大产品市场份额，从而提升公司行业地位；根据公司初步预测，项目达产后正常年份实现营业收入 23.14 亿元，利润总额 2.61 亿元，净利润 2.22 亿元。

3、企业研发中心建设项目：项目将极大改善公司研发的软硬件环境，为研发人员提供一个良好的研发平台，能够持续加快产品迭代升级和新技术突破，提升公司自主创新能力。

表 1：公司 IPO 募投资项目概况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)	项目投资期
1	绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	76,132.28	43,936.86	2 年
2	高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	48,237.55	39,718.22	2 年
3	企业研发中心建设项目	25,017.74	15,339.95	2 年
	总计	149,387.57	98,995.03	-

资料来源：公司招股书，华金证券研究所

（五）同行业上市公司指标对比

2025 年度，公司实现营业收入 23.95 亿元，同比增长 9.16%；实现归属于母公司净利润 2.04 亿元，同比增长 4.38%。根据管理层初步预测，公司预计 2026Q1 实现营业收入 4.00 亿元至 5.00 亿元，较 2025 年同期减少 28.08%至 42.46%；预计实现归母净利润 0.35 亿元至 0.45 亿元，较

2025 年同期减少 45.38%至 57.52%；预计实现扣非归母净利润 0.33 亿元至 0.43 亿元，较 2025 年同期减少 47.33%至 59.58%。

公司聚焦电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研产销；根据业务的相似性，选取洪田股份、东威科技、杭可科技、利元亨、金银河为泰金新能的可比上市公司。从上述可比公司来看，2024 年可比上市公司的平均收入规模为 18.19 亿元，平均 PS-TTM（算数平均）为 7.45X，销售毛利率为 22.47%；相较而言，公司营收规模处于同业的中高位区间，销售毛利率则未及同业平均。

表 2：同行业上市公司指标对比

代码	简称	总市值 (亿元)	PS-TTM	2024 年营业收入 (亿元)	2024 年 营收增速	2024 年归 母净利润 (亿元)	2024 年归 母净利润 增速	2024 年 销售毛利 率	2024 年 ROE (摊 薄)
603800.SH	洪田股份	80.12	6.71	13.74	-38.60%	1.17	-42.87%	23.78%	14.34%
688700.SH	东威科技	160.72	17.33	7.50	-17.51%	0.69	-54.25%	33.50%	3.99%
688006.SH	杭可科技	161.36	5.32	29.81	-24.18%	3.26	-59.67%	31.32%	6.35%
688499.SH	利元亨	90.66	3.51	24.82	-50.30%	-10.44	-455.34%	7.77%	-44.48%
300619.SZ	金银河	70.17	4.38	15.09	-33.00%	-0.81	-186.13%	15.97%	-5.01%
	平均值	112.61	7.45	18.19	-32.72%	-1.22	-159.65%	22.47%	-4.96%
688813.SH	泰金新能	/	/	21.94	31.42%	1.95	25.78%	21.16%	41.94%

资料来源：Wind（数据截至日期：2026 年 3 月 18 日），华金证券研究所

（六）风险提示

业务拓展失败的风险、公司海外业务拓展、下游铜箔行业周期性波动变化风险、下游应用领域市场需求波动的风险、宏观经济波动及产业政策变化风险、电池技术发展引发的需求风险、产品验收周期较长导致经营业绩波动的风险、主要原材料价格波动风险、核心技术泄密风险的风险等风险。

投资评级说明

公司投资评级：

买入 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%；

增持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%至 15%之间；

中性 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%至 5%之间；

减持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅在 5%至 15%之间；

卖出 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅大于 15%。

行业投资评级：

领先大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数领先 10%以上；

同步大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于-10%至 10%；

落后大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数落后 10%以上。

基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数为基准。

分析师声明

李蕙声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.cn